

凭借着全球首款后置四摄的 Galaxy A9s 以及首款“挖孔屏”设计的 Galaxy A8s ，三星 Galaxy A 系列在去年可谓是大放异彩。而事实上Galaxy A 系列在此之前就已经是三星定位于中端的一个重要系列，本期拆评就为大家带来去年年初的发布的一款机型——三星 Galaxy A8 的拆解。

文 | CrazyTin

校对 | Kelven



三星 Galaxy A8 采用后拆式设计，后盖通过一圈白色的防水胶固定，所以在打开后盖是需先用热风枪加热至200 度才能够将后盖分离出来。



主摄像头与保护盖之间配有黑色泡棉作为缓冲，而侧边则配有压力平衡膜。



取下主板盖后，手机的内部结构就非常清晰了。电池通过一圈白色胶条固定在中框上。



主板的屏蔽罩上覆盖了一层石墨片作为散热措施。

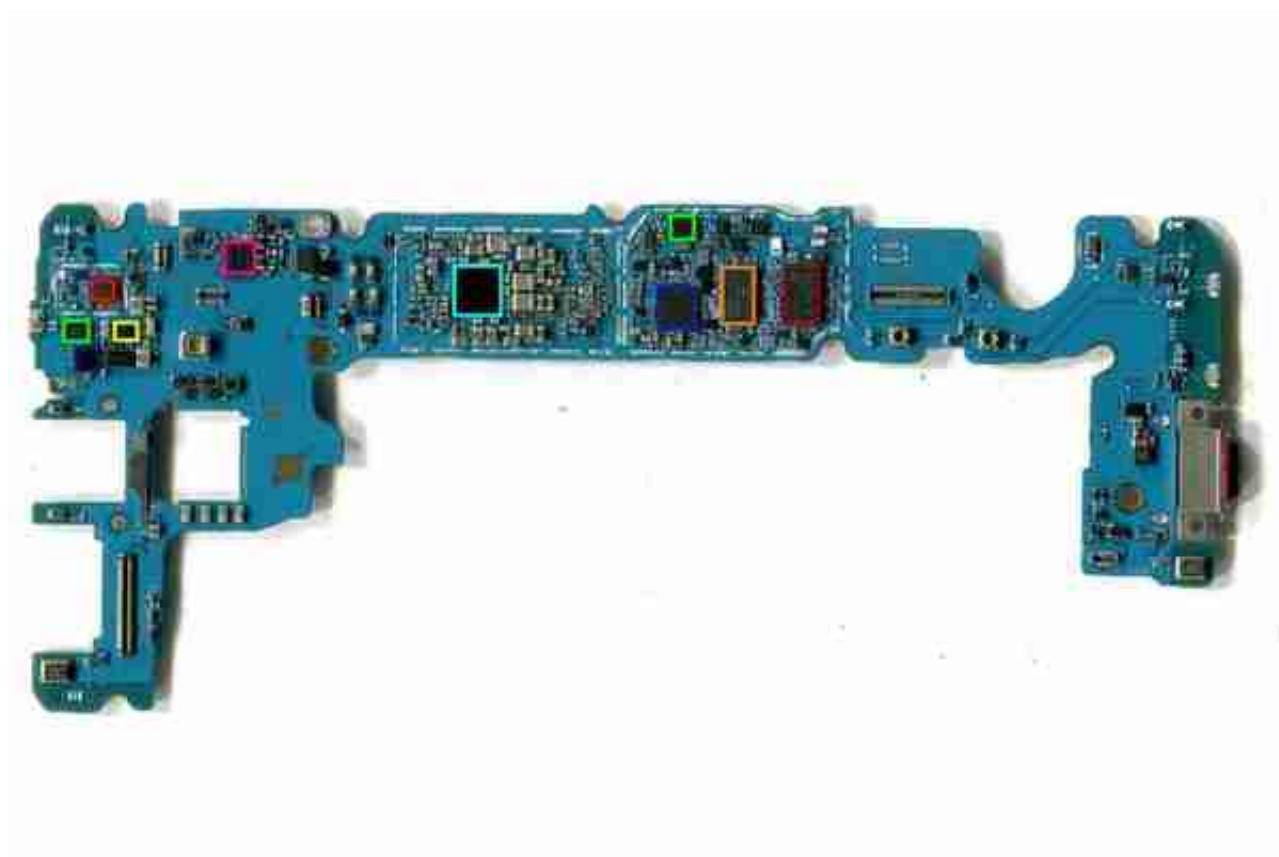


回到机身上继续拆解，副板位于手机上方听筒旁，听筒和副板天线盖表面均贴有一块泡棉。最后再将振动器、光线传感器、距离传感器以及按键和耳机孔从中框中取下。



主要元器件解析：

正面：



天蓝 : SAMSUNG-S527B-PowerManagement

红色 : S612 W1824-wifi , 蓝牙 , GPS

绿色 : STMicroelectronics-LSM6DSL-6-AxisAccelerometer+Gyroscope

深蓝 : STMicroelectronics-STM32F410-MCU

明黄 : NXP-TFA9872AUK-音频放大器

粉色 : Samsung-81RRXSJ-NFCController

深绿 : STMicroelectronics-LPS25H-BarometricPressure Sensor

蓝色 : SAMSUNG-SHANNON937-RFTransceiver

淡绿 : Skyworks-Sky77786-1-WiFi Dual-Band (2.4 GHz and 5 GHz)

橘红 : Murata-Front-End Module

暗红色：Murata-Front-EndModule

即便是 SIM 卡卡槽采用了双 SIM + microSD三卡槽设计，三星 Galaxy A8 主板上的空间也没有因此而变得过于紧张。主板仍然采用了三星一贯喜欢用的“条状”设计，处理器和内存采用了叠层封装，并将闪存设计在处理器模块旁，从刚才的详细拆解中已经可以知道，这样的设计师为了方便设计散热方案。

模组信息：

屏幕：



摄像头搭配方面三星 Galaxy A8 显得非常特别，该机采用了后置单摄 + 前置双摄的搭配。后置摄像头为 1600 万像素具备 F1.7 大光圈，模组来自三星自家，型号为 S5K2P6SX。



厂商名称	元器件型号	芯片功能	总价 (美元)	约合人民币
三星	S2D0504X01	显示设备电源管理	\$0.80	¥5.36
三星	S527B	电源管理	\$1.20	¥8.04
三星	KLMBG2JETD-B041	32GB 闪存	\$7.80	¥52.29
美光	Unknown	4GB 内存	\$19.00	¥127.36
三星	Exynos 7885	Exynos 7885 处理器, 基带处理器	\$32.00	¥214.50
三星	B1RRXSJ	NFC 控制器	\$1.80	¥12.07
Unknown	Unknown	Wi-Fi, 蓝牙, FM Radio	\$3.50	¥23.46
三星	SHANNON937	射频收发器	\$1.75	¥11.73
村田制作所	D5328	射频模块	\$1.50	¥10.05
Skyworks	Sky77786-1	双频 WiFi 接收器	\$1.24	¥8.31
整机预估价格为 \$227.76 (约合人民币 1526.72 元), 主控芯片占整机预估价格的 30.99%				

从刚才的模组信息再到现在的 Bom 表，可以看出三星 Galaxy A8 上绝大部分的 IC 元器件以及零部件都是由三星自家去生产的。而其中不得不提的，就有三星自家研发和生产的系列处理器 Exynos。

Exynos 是三星基于 ARM 架构设计研发的处理器品牌，自 2011 年 2 月面世至今已有非常多款经典的智能手机采用 Exynos 的处理器。其中最为人所熟知的，就有前三代的 iPhone。

而这次 Galaxy A8 上用上的 Exynos7885 处理器采用了 14nm 的工艺打造，内置两颗 Cortex-A73 核心以及六颗 Cortex-A53 核心。这款处理器主频达 2.1GHz，GPU 为 Mali-G71。

三星 Galaxy A8 拆解评分：



由于 Galaxy A8 具备 IP68 防水级别，所以在防水设计方面，后盖与中框采用防水胶去固定，麦克风、扬声器、卡托等均有针对的防水设计。整机共计使用了18颗螺丝进行固定，一定程度上减少了胶水的使用，所以手机内部的排布非常美观。